

集邦咨询：国家携手地方政策支持，重点扶植存储器及IC设计等三大领域

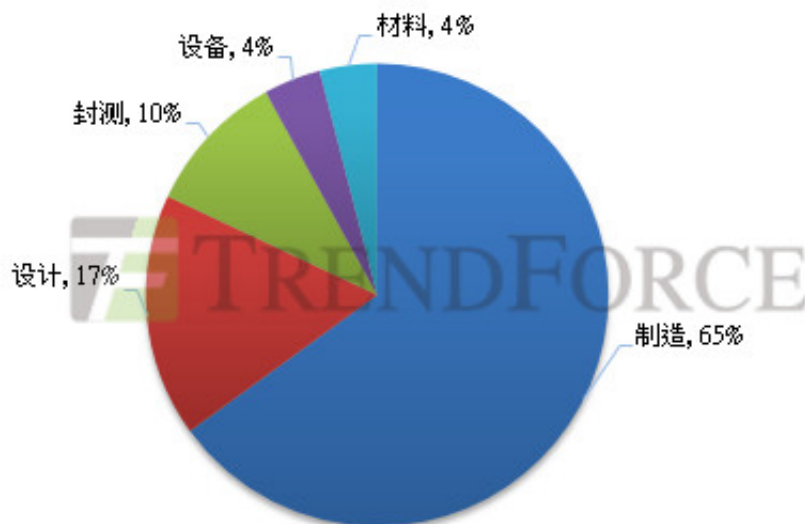
2017-11-21 张瑞华

中国半导体产业产值从2015年开始呈现爆发性成长，2018年产值预估将突破6,200亿元人民币，政府的政策支持成为主要驱动力。集邦咨询在最新的“中国半导体产业深度分析”报告中指出，政府从中央到地方对半导体产业支持力道将持续扩大，大基金除持续支持较薄弱但又很重要的产业链环节外，存储器相关、SiC/GaN等化合物半导体、围绕IoT/5G/AI/智能汽车等应用趋势的IC设计领域，将是政府主导的大基金未来投资的三大方向。

集邦咨询半导体分析师张瑞华指出，2014年是政策支持半导体产业发展的分水岭。2014年6月政府发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，同年9月大基金的成立，一改过去税收土地优惠补贴、研发奖励的方式，首次以基金来推动产业发展，透过并购参股等市场化投资方式，提升半导体产业技术水准及国际竞争力。

大基金成立以来的举措包括支持紫光并购展讯及锐迪科扩大规模、支持长电科技并购星科金朋提升技术实力，同时排名上升至全球第三大、支持通富微电并购AMD封装厂扩大战线。并且结合一系列提升国产化的动作，两手策略成功推升半导体产业的量与质，并逐步缩小与其他国家的差距。

图一、大基金于各产业投资比重(统计至2017年9月)



数据来源：国家大基金；集邦咨询整理，2017/11

大基金第一期主要投资IC制造，第二期IC设计投资比重将增加

从大基金的发展来看，集邦咨询指出，统计至2017年9月，大基金首期募资1,387.2亿元人民币，共投资55个项目，承诺出资1,003亿元人民币，实际出资653亿元人民币，其中IC制造因资金规模较大，占整体投资比重65%为最大。目前大基金第二期已在募资中，预计规模将达1,500-2,000亿元人民币，投资项目也将有所调整，集邦咨询预估，大基金在IC设计投资比重将增加至20%-25%，投资对象也将扩大到具发展潜力的新创企业。

另一方面，观察政府推动半导体产业发展策略，由中央带动地方发展的趋势已非常明确。至2017年6月，配合国家大基金而成立的地方半导体产业投资基金已达5,145亿元人民币，其中规模最大者高达500亿元人民币。各地方政府也因应中央的策略，陆续发布半导体产业专项政策，其范围遍及资金、研发、投资、创新、人才等，意味着地方政府不仅有发展半导体产业的决心，也为产业带来实际的支持。

此外，在多个地方政府积极投入半导体产业的带动下，其他城市也将崛起，集邦咨询指出，这也将导致未来几年中国半导体产业格局的改变，预期合肥、厦门、晋江等将可望成为中国新一代半导体产业重镇。

来源网址: 集邦科技 - 媒体中心 [集邦咨询：国家携手地方政策支持，重点扶植存储器及IC设计等三大领域](#)